

2006年4月20日制定

2008年7月9日修正

松下集团除外项目一览表

- 1) 包含在小型荧光灯内的水银，每只灯泡不超过 5mg 的
- 2) 包含在一般照明用的直管型荧光灯内的水银，不超过以下使用量的：
 - 使用卤磷酸钙类荧光体的灯泡 10mg
 - 使用三波长型荧光体的标准寿命的灯泡 5mg
 - 使用三波长型荧光体的长寿命的灯泡 8mg
- 3) 包含在特殊用途用的直管荧光灯类的水银
- 4) 包含在这里未记载的灯泡类的水银
- 5) 包含在显像管、电子零部件以及荧光管的玻璃中的铅
- 6) 在铅含有量在 0.35wt%（质量比，下同）以下的铁，铅含有量在 0.4wt% 以下的铝以及铅含有量在 4wt% 以下的铜合金中，作为合金成份而包含在内的铅
- 7) 包含在以下项目中的铅：
 - 包含在高熔点温度焊锡中的铅（例如：包含 85wt% 以上的铅的锡铅焊锡合金）
 - 用于服务器存储装置・存储阵列系统（array system）、信号转换・送发接受信息・转送以及电气通信网络管理用的网络基础设备的、包含在焊锡中的铅
 - 包含在电子陶瓷零部件中的铅（例如：压电元器件（piezoelectronic device））
- 8) 在规定的对电气接点中的镉及其化合物、以及特定的危险物质以及调剂的销售以及使用进行限制的指令（76 / 769 / EEC）的修正指令（91 / 338 / EEC）中所禁止的用途以外的、包含在镀镉内的镉及其化合物
- 9) 作为吸收式电冰箱的碳素钢制冷系统的防锈处理的六价铬
- 10) 包含在铅青铜制轴承体以及推手中的铅
- 11) 用于顺应针连接器系统（compliant pin connector systems）的铅
- 12) 用于热传导模块型 C 环的、作为编码材料的铅
- 13) 包含在光学玻璃以及过滤玻璃中的铅以及镉
- 14) 用于微处理器（microprocessor）的针头以及封装之间的结合的、由铅含有量超过 80wt%，而又未满足 85wt% 的两种以上的元素所构成的焊锡的铅
- 15) 在集成电路封装覆晶（flip-chip）的内部半导体模具以及载体之间切实地进行电气接续所需要的焊锡中所含的铅

修正错误记载

2008.7.9	2)	修正 ・使用三聚磷酸铝类荧光体的灯泡 → 使用卤磷酸钙类荧光体的灯泡
----------	----	---------------------------------------